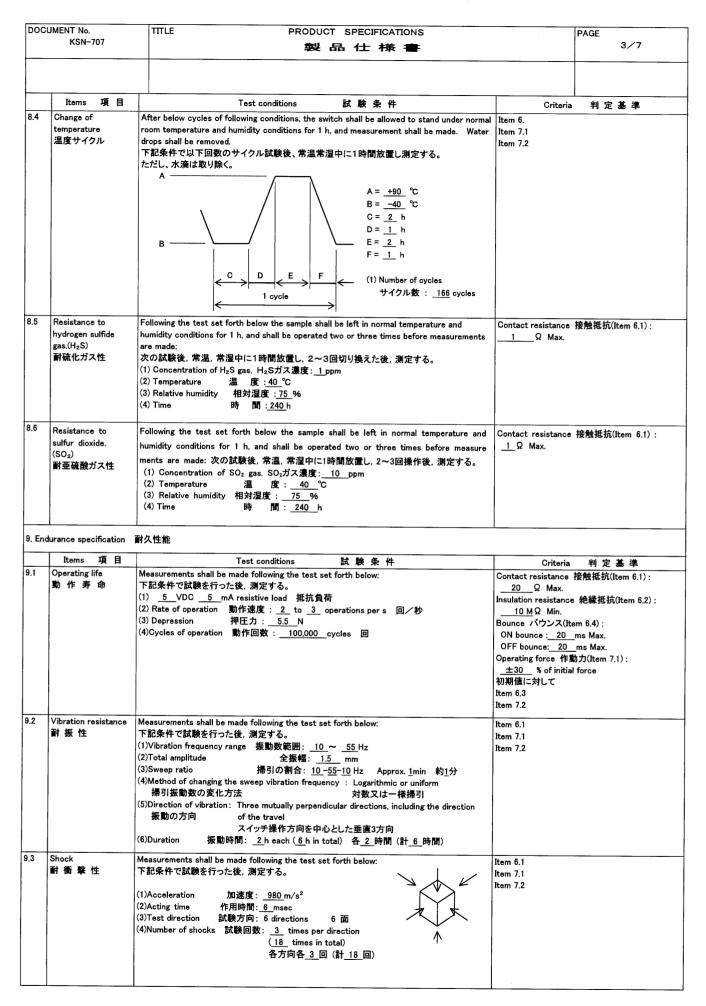
DOC	UMENT No.	TITLE		DODUCT OF				
DOG	KSN-707	TITLE	P	RODUCT SPI 最 品 4	ECIFICATIONS 土様		PAGE 1/7	
BACI	KGROUND							
1. Ge	eneral 一般事項	1						
1.1	Application 適用範	囲 This specification	n covers the re	quirements for si	ngle key switches v	which have no key	/ top.	
		(TACT SWITCH	IES : MECHANI	CAL CONTACT).				
1.2	Operating temperature ra	この規格書は、 ange 使用温度範囲:			トスイッチ:メカニカルコンタ humidity, normal a			
	,		erature range sh	all refer to the ra	nge where this swi	itch keepselectri	cal function within such temperatures.	
	.	使用温度範囲と	はスイッチがON	I-OFF機能を維持	する温度範囲を言	う。		
1.3	Storage temperature rang				<u>0</u> ~ <u>90</u> °C (n <u>20 </u> ~ <u>50</u> °C (ormal humidity, n	ormal air pressure 常湿·常圧)	
1.4	Test conditions 試験状	態 Unless otherwise	specified, the a	atmospheric cond	itions for making m	numidity 運度:20 neasurements and)∼85%) I tests are as follows.	
		試験及び測定は	特に規定がない	\限り以下の標準	状態のもとで行う。			
		Normal ter Normal hui			erature 温度 5~3 e humidity 湿度 2			
		Normal air			essure 気圧 86~		60mbar})	
					conducted at the f	ollowing condition	s.	
		ただし、判定に疑 Ambient te						
		Relative hu		対湿度: 60~70				
		Air pressur	-		06kPa{860∼1060			
		Switch shall be m スイッチは回路基	tourned on PWB 板から浮かない	without any India ように取り付ける	eation of switch flo	ating.		
	pearance, style and dime Appearance 外観			ffect the cension	ability of the produ	~ +		
		性能上有害な欠			willy of the produ	UL.		
2.2 5	Style and dimensions 形	状、寸法 Refer to	the assembly de	rawings. 製品図	による。			
3. Typ	pe of actuating 動作形:	式 <u>Tac</u> tile feedback	く タクティー	レフィードバック				
4. 00	ntact arrangement 回路			各 <u>1</u> 接点 ntare given in th	assembly drawing	rs 同窓の詳細	⊞は製品図による)	
	tings 定格				accombly diaming	29 E35005F7	当み表明日: 「-みの/	
	Maximum ratings 最大定 Minimum ratings 最小定							
0.2	www.man.ratings gg.j.yc	V DO _	<u>10μ</u> Λ					
6. Ele		気的性能						
6.1	Items 項目 Contact resistance	Te Applying a below static I	st conditions	試験 er of the stem m		ha mada	Criteria 判定基準	
	接触抵抗	スイッチ操作部中央に下	記の静荷重を加	ロえ,測定する。	oasuromonts snan	be made.	<u>100 m</u> Ω Max.	
		(1) Depression	押圧力: <u>9</u> 1					
		(2) Measuring method		method at 5VD0		meter or voltage		
			1kHz	散少電流接触抵	亢計, 又はDC5V 10	0mA電圧降下法		
6.2		Measurements shall be n		ne test set forth	below:		_100 M Ω Min.	
	Ann Am 1-1-1-1-1	下記条件で試験を行った (1) Test voltage 印:	:俊, 凋疋する。 加電圧: <u>100</u> \	/ DC for 1 min.				
		(2) Applied position 印	加場所:Betwee	n all terminals. A	nd if there is a met	al frame,		
		between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間						
						金属ノレーム間		
6.3		Measurements shall be n 下記条件で試験を行った		ne test set forth l	pelow:		There shall be no breakdown.	
		「記来庁で試験を刊づた (1)Test voltage 印加電		AC (50~60Hz)			絶縁破壊のないこと。 	
		(2)Duration 印加時間 : 1 min						
		(3)Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)				tal frame,		
					round (frame) ある場合は, 端子と	:金属フレーム間		
		-						
							DSGD 30. May .2019	
							Lee Gana hoon	
							CHKD. 30. 2017	
							John	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			APPD. 30 May 29	
PAGE	SYMB BA	CKGROUND	DATE	Appe	2005		1 35	
	DA'		DVIE	APPD	CHKD	DSGD	-1) · (1)	

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE	
KSN-707		製品仕様書	2/7	
-				
	Items 項目	T4 1'4' ## ## ## ## ##		
6.4		Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
6.4	Bounce パウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のパウンスを測定する。 Switch Oscilloscop オシロスコープ "ON" "OFF"	ON bounce :20ms Max. OFF bounce:20ms Max.	
7. Me	chanical specification	機械的性能		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
7.1	Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷量を加え、操作部が停止するまでの最大荷量を測定する。	<u>4.5 N</u> ± <u>1 N</u>	
7.2	Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured	±0.1_mm	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力: 5.5 N		
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	0.2 N Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 50 N (2) Time 時間: 15 s (3) Number of times 回数: 1 time	Keep electrical ON/OFF. 電気的にON-OFFすること。 Item6.1	
		CO TOMBOO OF CHIEF DE SA.		
8. Env	ironmental specification			
0 1	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
8.1	Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: -40 ± 2 °C (2) Time 時間: 1000 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.2	Heat resistance 耐 熱 性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: 90 ± 2 °C (2) Time 時間: 1000 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.3	Moisture resistance 耐 湿 性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 60 ± 2 ℃ (2) Time 時間: 1000 h (3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):	



DOC	JMENT No. KSN-707	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/7
. So	ldering conditions 半	田付条件	
0.1	Items 項目 Hand soldering 手 半 田	Recommended conditions 推 奨 条 件 Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature	
	Reflow soldering リフロー半田		. <u>3</u> s Max. ture ピーク温度
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	(1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejectidesigned, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹きフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを(5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in towest temperature possible. 熱度歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い(7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8) The thickness of cream solder: 0.15 mm クリーム半田印刷厚: 0.15 mm	on. Therefore, when the PWB is 上げ等によりスイッチ側面から 設けないで下さい。 u have the right one before use. ne shortest period and at the

DOCUMENT No. KSN-707	CT SPECIFICATIONS	PAGE
1.6.1	 品仕様書	5/7

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General — 粉項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等 へも当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual)equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, automotive device, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、車載機器、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。従いまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A4. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
 - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PWBoard process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. After reflow treatment of this switch, this switch is not allowed for wave/flow soldering at the backside of PWB. Due to jet stream, flux may penetrate into inside of switch.
 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田しないで下さい。フラックス吹き上げによりスイッチにフラックスが得入する場合があります。
- B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- B5. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。

スト、Aleiga 500 73 かが179 ようと、スキップの成形を破している。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

- B6. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

DOCUMENT No. KSN-707	DUCT SPECIFICATIONS L品仕様書	PAGE 6/7

- D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move. ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。(ストッパー強度参照)

D7. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

- D8. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D9. Please avoid designing keytop to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact applied to switch body. セットキートップがセット筐体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因となります。
- D10. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB. 基板がたわむような場所への設置はお避け下さい。
- D11.This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior colsultation with us is also needed.
 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。
- D12. Shape of keving tip: 打鍵部先端形状

It is recommended that the tip of the keying section is to be flat(ϕ 2.5). Also, ABS or PC resign is recommended for its material. ϕ 2.5mmフラット形状を推奨いたします。尚、材質はABSまたはPC等の樹脂を推奨致します。

D13. The inclination of the striking part shall be within 2. 打鍵部の傾斜は、2度以内に設定して下さい。

D14. Press the center of the stem. If the keytop is displaced, it might impact degradation in electrical and mechanical performance ステムの中心を操作してください。ステム天面からキートップ先端が外れると、電気的・機械的特性が劣化する恐れがありますのでご注意下さい。

E. Using environment 使用環境

E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
 - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品, ゴム材料, 接着剤, 合板, 機器の梱包材, 機器内の駆動部に使用される潤滑剤については, 硫化, 酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム, グリース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが 発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では,端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. The below usage and/or environment shall be avoided. This product may face an increase in contact resistance and degraded solderability. 本製品を以下の環境下及び期間で保管されますと接触抵抗の上昇やはんだ付け性の悪化が発生する恐れがありますので避けてください。
 - (1) Direct exposure to sunlight 直射日光の当たる場所。
 - (2) Storage at lower than -20 dgrs C, higher than +50 dgrs C, and/or lower than 20%, higher than 85% humidity -20°C~+50°Cの範囲外の温度、-20%~+85%の範囲外の湿度の環境
 - (3) Corrosive gas 腐食性ガスの雰囲気。
 - (4) Longer than 6-month storage after being delivered 製品納入後6ヶ月超える長期保管。
- F2. Once the original packaging is opened, the remained products shall be repackaged and stored in the ALPSALPINE original packaging. 開封後で残品がある場合、ALPSALPINE出荷時の梱包状態で保管してください。

DOCUMENT No. KSN-707	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	製品仕様書	7/7
F3. The products shall be sto	ored in the ALPSALPINE original packaging without overstack or external stress that may potentially caus	e deformation of packaging.
	過剰な積み重ねや応力を避けてALPSALPINE出荷時の梱包状態のままで保管してください。	
	ot as released position, when they are stored. 切ったままでの保存はしないでください。	
G. Others. その他		
本仕様書は発行日より	: invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。	
G2. Please understand that t 電気的, 機械的特性, タ	the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be chang 小観寸法および取付寸法以外につきましては,当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじ	ed at our own discretion. いの御了承下さい。
G3. Never use the product b	reyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to son	ne abnormal conditions,
you must take certain pro 定格を超えての使用は して下さい。	otective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は	保護回路等で電流遮断等の対策を
	f the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain fi	rom using it in the place where it can
catch fire, or take meas	sures to preclude catching fire. 対版等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の	
禁止するか,類焼防止丸	対策をお願いします。	
requiring higher safety, v	t in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefor we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case t	e, if you use a switch for a product he switch alone should fail.
スイッチの品質には万全	whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視される	セットの設計に際しては、スイッチの単
お願いします。	としての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確	保して頂きますように
36. TACT Switch is tradema タクトスイッチはアルプス	ırk or registered trademark of ALPSALPINE CO.,LTD ミアルパイン株式会社の商標もしくは登録商標です。	

